

东芯半导体股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

东芯半导体股份有限公司（以下简称“东芯股份”或“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东的利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于 2024 年 4 月 20 日制定并发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），以切实履行上市公司的责任，进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力，塑造良好的资本市场形象，积极回报投资者。2024 年上半年（以下简称“报告期”），公司积极开展和落实行动方案各项工作，现将行动方案半年度评估情况公告如下：

一、聚焦公司主业，优化业务布局

2024 年上半年，公司继续深耕存储芯片主业，主动适应不断变化的经营环境，持续加大技术和产品研发的投入。同时公司以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，拓展行业应用领域，优化业务布局，以期为客户提供更多样化的芯片解决方案。公司注重自主知识产权，坚持长期主义下的技术创新，致力于持续为企业、行业和社会创造价值。

（一）深耕主营业务，坚持技术创新

报告期内，公司基于 2xnm 制程，持续进行 SLC NAND Flash 产品系列的研发，不断扩充产品线。公司坚持技术创新，努力推进公司产品制程的进一步升级，公司先进制程的 1xnm SLC NAND Flash 产品的研发工作已取得阶段性进展，产品已达成部分关键指标，为确保产品质量与性能稳定，目前正持续进行设计优化和工艺调试等技术攻关工作。

公司基于 48nm、55nm 制程，持续进行 64Mb-1Gb 的中高容量 NOR Flash 产品研发工作，根据不同容量的目标客户群进行精确定位，保证性能、功耗和性价比的合理匹配。随着公司 NOR Flash 产品持续迭代升级，产品品类不断丰富，将为可穿戴设备、安防监控、物联网、汽车电子等领域的客户提供多样化、高可靠性的产品选择。

目前公司的 DRAM 产品包括 DDR3(L)、LPDDR1、LPDDR2、PSRAM，以及正在进行客户送样及市场推广的 LPDDR4x。公司将继续在 DRAM 领域进行新产品的研发设计，助力公司产品多样性发展。

公司目前已可以向客户提供高至 8Gb+8Gb、16Gb+16Gb 的 MCP 产品，主要应用于车载模块等领域。公司将继续开发更高容量组合的 MCP 产品，以便为客户提供更多样化的产品选择。

（二）围绕存储主业，优化业务布局

公司以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，以期为客户提供更多样化的芯片解决方案。

报告期内，公司新增投入研发力量，出资设立上海亿芯通感技术有限公司（以下简称“上海亿芯”），从事 Wi-Fi 7 无线通信芯片的研发、设计与销售。报告期内公司已完成上海亿芯及其子公司、分公司的设立，已完成项目团队的组建，研发项目正在持续推进中。

报告期内，公司筹划了对外投资项目，拟对砺算科技（上海）有限公司（以下简称“上海砺算”）进行投资，该公司是一家致力于研发多层次（可扩展）图形渲染的芯片设计企业，力争解决国产主流完整 GPU 架构自主可控的关键问题。截至本评估报告发布日，公司已完成投资协议的签署，拟通过自有资金人民币 20,000 万元进行增资，增资完成后公司将持有上海砺算约 37.88% 的股权。

（三）保持高水平研发投入，坚持核心技术自主可控

公司报告期内研发费用 10,576.55 万元，同比增长 26.31%。报告期内，申请发明专利 4 项（其中中国发明专利 2 项，PCT 国际阶段发明专利申请 2 项），获得发明专利授权 12 项（其中中国发明专利 1 项，美国发明专利 1 项，韩国发明专利 10 项）；申请集成电路布图设计权 5 项，获得集成电路布图设计权 5 项；申请注册商标 4 项；申请软件著作权 1 项，获得软件著作权 1 项。截至报告期末，公司拥有境内外有效专利 95 项、软件著作权 15 项、集成电路布图设计权 86 项、注册商标 14 项。截至报告期末，公司累计申请境内外专利 177 项，获得专利授权 95 项，专利涉及 NAND、NOR、DRAM 等存储芯片的设计核心环节，公司技术实力不断提升。

（四）稳步推动募投项目

公司持续强化募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，科学合理使用募集资金，切实保证募投项目顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，进一步丰富公司产品种类、提升产品性能，持续强化公司的创新能力，增强公司整体盈利能力。

报告期内，公司“1xnm 闪存产品研发及产业化项目”已取得阶段性进展，产品已达成部分关键指标，但项目涉及的制造工艺复杂，并且生产验证周期较长。因此，为确保产品质量与性能稳定，后续仍需更多时间进行设计优化和工艺调试等技术攻关工作。经重新论证后，该项目继续实施仍然具备必要性和可行性。公司经审议，将该募投项目延期至 2025 年 6 月 30 日。

报告期内，公司募投项目“车规级闪存产品研发及产业化项目”，公司研发的车规级闪存产品已通过 AEC-Q100 的验证，已实现车规级闪存产品的销售；公司募投项目“研发中心建设项目”已达成预期的研发中心建设目标，其中 LPDDR4x 已完成研发并进入量产阶段。以上两个募投项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件并予以结项。

二、完善公司治理，提升规范运作水平

公司已按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，建立了包括股东大会、董事会、监事会和管理层组成的较为完善的公司治理结构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间的权责明确、运作规范的公司治理体系。

报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司治理的实际情况，对《东芯半导体股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》等 28 部公司治理制度进行了制定、修订。

公司重视董事、监事、高级管理人员等“关键少数人员”的培训工作，组织相关人员积极参加各类培训，加强证券市场相关法律法规的学习，不断强化合规意识，提升公司董监高履职能力，推动公司持续规范运作。

三、加强投资者沟通，提升信息披露质量

报告期内，公司通过上证路演中心召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，组织、参加了路演、反路演、策略会等共计约 107 场投资者交流会，并通过股东大会、上证 e 互动、公司网站投资者关系专栏、微信公众号、投资者电话与电子邮箱等各种多样化方式和渠道开展投资者沟通与交流活动，保障投资者对公司信息的全方面了解，引导投资者更好理解公司的投资价值，增强投资者对公司的信心，并认真听取投资者对公司的意见和建议，助力公司高质量发展。

公司积极承担环境责任、社会责任和公司治理责任，将 ESG 理念融入公司整体战略和业务运营中，制定具体的 ESG 政策和指南，以提高 ESG 治理水平。报告期内，公司披露了 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告，对公司在上述责任领域的实践与绩效进行了汇报与总结，详见公司 2024 年 4 月 20 日披露的《东芯股份：2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

四、完善投资者回报机制，提升投资者信心

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，公司于 2023 年 5 月推出股份回购方案。截至 2024 年 5 月 8 日，公司已完成回购，已实际回购公司股份 3,218,219 股，占公司总股本的 0.7277%，回购最高价格 38.77 元/股，回购最低价格 22.80 元/股，回购均价 31.09 元/股，使用资金总额 10,006.27 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

五、强化管理层责任，建立管理层与公司股东的风险收益共担机制

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了与公司业绩紧密相关的激励计划。2024 年 4 月，公司公布了 2024 年限制性股票激励计划，对公司管理层及核心员工授予限制性股票。公司为上述股权激励计划设置了公司层面及个人层面的考核指标。公司选取了营业收入增长率作为公司层面的业绩考核要求，并对所有激励对象设置了个人层面的绩效考核要求，根据激励对象的年度考核结果确定激励对象是否符合归属条件。

以上考核体系可以有效实现股权激励的约束作用，提升激励对象的积极性，有助于提升公司活力及发展动力，促进公司发展，增强投资者回报。

报告期内，公司继续严格落实股权激励计划的考核指标要求，严格执行股权激励计划实施考核管理办法，确保管理层与核心员工与公司目标一致，心系股东利益，实现风险收益共担，共同促进公司可持续健康发展，增强投资者回报。

六、其他事宜

截至本评估报告披露日，公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中。公司将持续评估“提质增效重回报”的行动方案的执行情况，并及时履行信息披露义务。未来，公司将持续深耕主业，强化核心竞争力、提升盈利能力、提高公司治理水平，履行上市公司责任，塑造良好的市场形象，切实维护投资者利益，增强投资者信心，为股东创造更多的投资回报。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

东芯半导体股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日